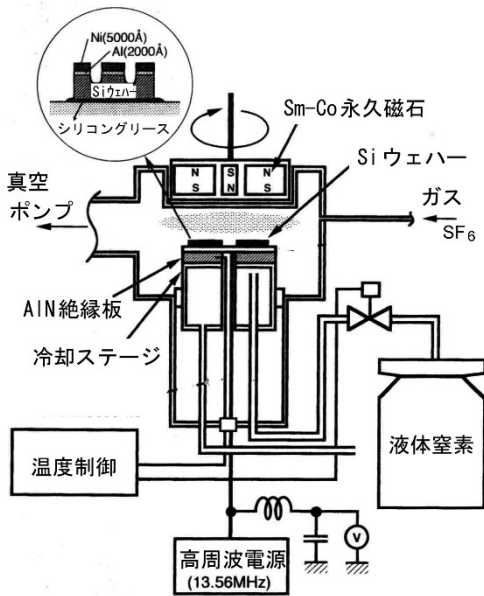
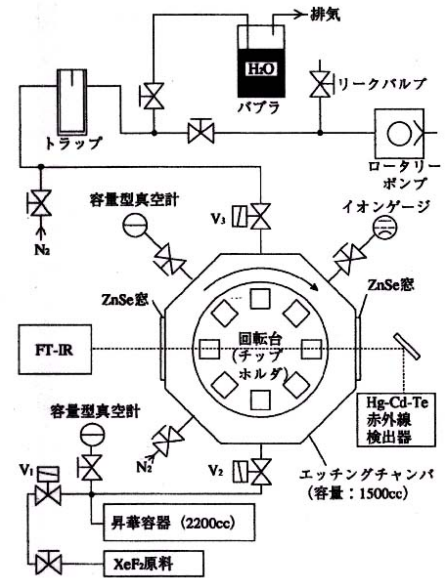


5 マイクロマシニングとパッケージング

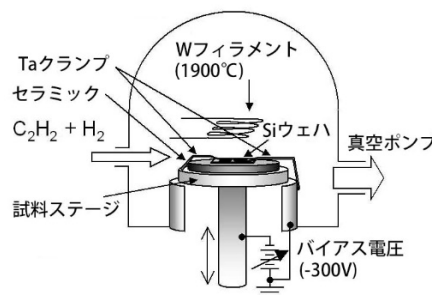
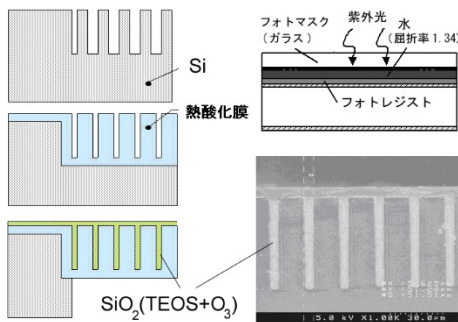


Deep RIE 装置とそれによる振動ジャイロ



XeF₂による Si エッチングの装置

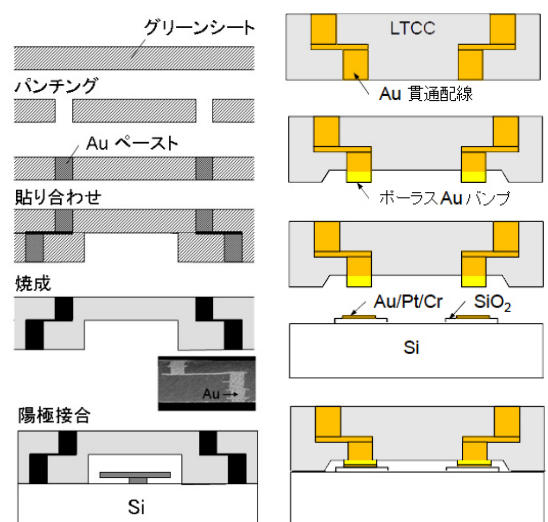
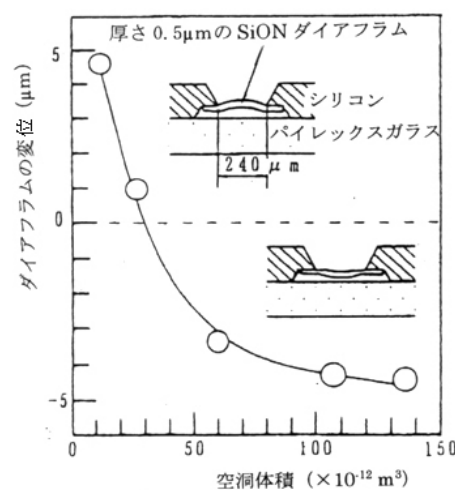
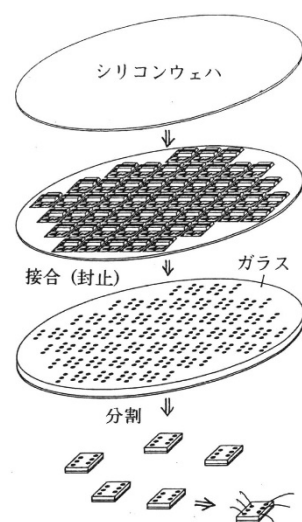
(M.Takinami, Tech. Digest of the 11th Sensor Symp.(1992) 15) (R.Toda, Sensors & Actuators, A66 (1998) 268)



液浸コンタクトリソグラフィとトレンチリフィル カーボンナノチューブ成長(やダイヤモンド薄膜堆積)に用いられるホットフィラメント CVD

(K.S.Chang, et.al, J.of Micromech. Microeng., 15 (2005) S171)

(T.Ono et.al., Nanotechnology, 13 (2002) 62-64)



ウェハレベルパッケージングと陽極接合時の酸素発生検証 貫通配線付 LTCC によるウェハレベルパッケージング

(M.Esashi, J.of Micromech. and Microeng., 18 (2008) 073001) (S.Tanaka et.al., Technical Digest IEEE MEMS, (2012) 369)